RTP ウェーハの BMD 析出核 (VO_x) 構造に関する理論的研究 Theoretical Study on Structure of BMD Nuclei (VO_x) in RTP Wafers

グローバルウェーハズ・ジャパン株式会社 ¹, 岡山県大院情報系工 ², 岡山県大情報工 ³ ○岩城 浩也 ^{1,2}, 須藤 治生 ¹, 早川 兼 ¹, 神山 栄治 ¹, 末岡 浩治 ³

GlobalWafers Japan Co., Ltd.¹, Graduate school of Computer Science and systems Engineering, Okayama Prefectural Univ.², Okayama Prefectural Univ.³

OHiroya Iwashiro^{1,2}, Haruo Sudo¹, Ken Hayakawa¹, Eiji Kamiyama¹, and Koji Sueoka³ E-mail: Hiroya_Iwashiro@sas-globalwafers.co.jp

シリコン (Si) ウェーハへ侵入した金属不純物のゲッタリングサイトとして機能することが知られる Bulk Micro-defect (BMD) の形成手法の 1 つに Rapid Thermal Process (RTP) がある。RTP によって生成された高濃度の原子空孔 (V) は酸素 (O) と空孔-酸素複合体 (VO_X) を形成し,BMD の析出核形成に寄与すると考えられる[1]。RTP ウェーハの VO $_X$ 形態は,Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) による分析で少なくとも VO $_4$ の存在が検出されている[2]。また,BMD 密度と V 濃度には相関がある事が判明しており,BMD 密度は V 濃度の 4 乗に比例する[3]。これより,BMD 析出核の形態は VO $_4$ と推定される。VO $_4$ の安定構造は先行研究より提案されているが[V0 $_4$ の具体的な安定構造を提案した先行研究はない。そこで,本研究では,第一原理計算を用いて,VO $_4$ が V0 $_4</sub> が <math>V$ 0 $_4$ 個集まる際の結合エネルギー (V0 $_4</sub> を算出し,<math>V$ 0 $_4$ の安定構造を探索した。

計算モデルは、Si 原子 512 個からなる立方体モデルを用意した。この Si モデルに VO_4 を 4 個配置するが、無作為に配置した場合、計算を行うモデル数が非常に多くなる。そこで、本研究では、2 回対称性を有する V 配置、3 回対称性を有する V 配置、2 回対称性と 3 回対称性両方を有する V 配置の 3 種類を考慮する。これらの V 配置へ,0 を 16 個配置し $4VO_4$ 構造を作成した。作成した $4VO_4$ モデルの全エネルギーを第一原理計算より求め、 VO_4 が 4 個集まる E_b を算出した。

計算の結果、3回対称性を有する V配置より、2回対称性を有する V配置の方が E_b は大きくなる結果となった。3回対称性を有する V配置は、2回対称性を有する V配置に比べ、V同士の距離が離れている。そのため、 VO_4 同士が強く結びつくことができず、エネルギー的に不安定になったと考えられる。また、2回対称性を有する V 配置の中でも、図 1 に示す $4VO_4$ 構造の E_b が最も高くなり、3.6 eV を示した。これは、 VO_4 が 4 個集まる事でエネルギー利得がある事を示しており、RTP で導入された VO_4 が BMD へ成長する過程で $4VO_4$ の形態となる可能性は十分にある。

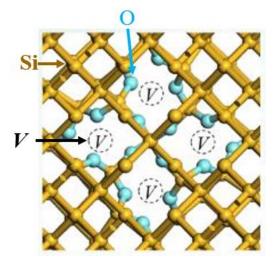


Fig. 1. The Most stable structure of 4VO₄.

- [1] R. Falster, V. V. Voronkov, F. Quast, physica status solidi (b), Volume 222, Issue 1, pp. 219-244.
- [2] V. Akhmetov, G. Kissinger, and W. von Ammon, Physica B,404 (2009) p.4572.
- [3] Haruo Sudo, et al., ECS Journal of Solid State Science and Technology, 8(1)P35-40(2019)
- [4] G. Kissinger, et al., Journal of The Electrochemical Society, 158(4) H343-H346(2011)